

深南电路——工艺课题项目背景

序号	项目名称	项目背景	可能的专业或领域
1	一种高分子缓冲材料的开发	环氧玻璃布树脂在高温压合过程中由于图形设计不同会存在温度和压力传递的不均匀，这种不均匀会带来很多压合的缺陷，需要一种能够缓冲压力和热量的高分子材料，解决压合过程中设计不均匀带来的问题	高分子化学
2	PCB外层形变研究	PCB的加工流程会经过烘烤、电镀、磨刷、蚀刻等一系列的过程，其中涉及到温度变化，各种机械受力，化学应力。这些力累积起来会造成产品不规则的形变，影响产品性能。	材料力学 数理统计分析
3	曝虚机理研究	PCB产品受产品形变、设备光源、光源波长、曝光参数等因素影响经常出现曝虚现象，需要研究清楚产生机理，彻底解决问题。	光学（照相原理） 物理（光的折射和反射）